

証券コード6146



カッティングエッジ CUTTING EDGE

72期事業のご報告

平成22年4月1日～平成23年3月31日



Cutting Edgeという言葉には、「刃の先端」「最先端」という意味があります。ディスコが創業当初より「砥石(刃)」を作り続けることで培い、受け継いできたモノづくりへの熱意を糧に、これからの最先端の技術領域を切り拓いていきたいという思いを、このタイトルに込めました。

本誌では、ディスコの業況や経営方針、財務状態や最新技術情報などを株主のみなさまにタイムリーにお伝えしていきます。

なお、Cutting Edgeは72期 通期よりペーパーレス化し、Webサイトのみでの掲載とさせていただきます。ディスコは法令に定められた範囲にとどまることなく、これからも積極的なIR活動に努め、適切かつ合理的な手法を用いて情報開示を行ってまいります。

 会社概要

 株式情報

株式会社 **ディスコ**

スマートフォンなどの市場拡大を背景とし、顧客ニーズに柔軟に対応したことで、売上高は過去最高を更新しました。



代表取締役社長 関家一馬

3月11日に発生した東日本大震災において被災された方々に、謹んでお見舞い申し上げます。また一刻も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。

事業環境・業績

当期(2010年4月1日から2011年3月31日まで)の世界経済は、地域によるばらつきがあるものの、中国などの新興国経済が牽引役となり、概ね堅調に推移しました。半導体業界においては、第3四半期にメーカ各社が一時的な在庫調整を行なったものの、スマートフォンなどの世界的な流行が底堅い需要に繋がり、期全般を通じて良好な状態が継続しました。当社グループはこのような状況のなかで積極的な販売活動を行った結果、当期の売上高が過去最高を更新いたしました。

精密加工装置においては、ICやパッケージシンギュレーション向けのダイシングソーの出荷が堅調に推移したことに加え、レーザーではLED向けの出荷台数が前年度に比べ大幅に増加しました。これは従来のバックライト用途に加え、照明用途の市場が急速に立ち上がってきたことによるものです。また、グラインダはウェーハの薄化技術の進展に伴い、ハイエンド機を中心に出荷が大きく伸びました。消耗品である精密加工ツールについては、為替の影響を受けたものの、半導体の生産数量の増加に比例し、過去最高の出荷数量となりました。

顧客ニーズ対応力の向上

半導体需要が堅調に推移するなか、ディスコは市場のさらなる拡大に対応すべく、製品供給能力や国内外拠点サービス力、社内組織力など、企業としての総合力の向上に努めております。特に、半導体・電子部品業界の

構造変化により生産拠点がこれまで以上に集中するアジア地域においては、積極的な設備投資を継続し、拠点能力の増強とお客様満足度の向上を図ってまいります。また、高度化するウェーハ薄化技術や、新たな用途への広がりを見せるレーザーアプリケーション、さらに今後見込まれるウェーハサイズの450mm化などに対応すべく、ディスコは今後も研究開発活動を加速させ、製品ラインナップの拡充やアプリケーション技術の向上を行ってまいります。

DISCO VISION 2020を策定

ディスコは、『2010年におけるあるべき姿』を描いた「DISCO VISION 2010」の実現に向けて、1997年から全社を挙げて取り組んでまいりました。この度、その達成年度を迎えたことから、DISCO VISION 2010を形成する各指標について振り返りを行った結果、全24項目のうち16項目が基準をクリアし、その割合は66.7%となりました。この結果を踏まえ、さらにこれからの10年間についての“あるべき姿”を設定した「DISCO VISION 2020」を新たに策定いたしました。「DISCO VISION 2020」は『企業を構成する要素』と『当社を取り巻くステークホルダーとの関係性』の2つの観点を取り入れており、ディスコの将来像をより多面的・立体的に描いています。

今後、どんな環境においても生き抜く卓越した生命力を持つ企業となるよう、ディスコの従業員一人一人が主体性を発揮して企業活動の質の向上に努めてまいります。株主のみならず皆様におかれましては、一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2011年6月

代表取締役社長 関家一馬

財務ハイライト

売上高・経常利益・経常利益率



純利益・1株当たり純利益



総資産・自己資本比率



配当金・配当性向



当期の概況

当期の半導体業界や電子部品業界では、スマートフォンやタブレットPCなどの最終製品需要の拡大から、DRAMやNANDフラッシュ、電子部品などメーカ各社による増産の為に設備投資が非常に活発に行われました。また、薄型TVのバックライト用途に加え、照明用途にも需要が増加しているLEDの設備投資も積極的に行われました。

当社グループは、このような市場環境に合わせ積極的な販売活動と生産対応に努めた結果、売上高は過去最高を記録し、為替の影響による売上高総利益率の伸び悩みや研究開発費など販売管理費の増加があったものの、前期と比較して大幅な増益となりました。

以上により2010年度の業績は、売上高997億円(前期比61.5%増)、営業利益159億15百万円(同241.0%増)、経常利益171億90百万円(同276.9%増)、純利益109億45百万円(同343.1%増)となりました。

■財政状態について

当期末の総資産は1,392億40百万円(前期比149億27百万円増)となりました。これは製品需要の拡大により受取手形および売掛金が増加したほか、急激な装置需要に合わせた棚卸資産の増加などによるものです。一方、負債合計は416億6百万円(前期比53億85百万円増)となりました。これは材料などの仕入れが増加したことにより支払手形及び買掛金や未払金などが増加した一方、長期借入金が減少したことによるものです。これらの結果、純資産は976億33百万円(前期比95億41百万円増)となり、自己資本比率は69.4%(前期比0.9ポイント減)となりました。

■配当について

当社は業績に連動した配当を実施することを基本方針とし、配当性向は連結当期純利益の20%としておりますが、利益水準に関わらず安定配当として最低限年間20円を維持いたします。なお、次期(2012年3月期)より業績をよりリアルタイムに反映した配当政策へ変更いたします。これまで「配当性向を連結当期純利益(通期)の20%」としておりましたが、中間、期末の配当総額についてそれぞれ「連結半期純利益の20%」と変更いたします。

当期の配当につきましては、1株当たりの中間配当を25円としましたので、従来の配当政策に基づき、期末配当は40円(年間65円)とさせていただきます。

(注)ただし安定配当に関する方針に変更はありません。

通期の連結業績予想

半導体・電子部品市場の需要は堅調で、メーカ各社の設備投資は引き続き高水準で推移すると見込んでいます。精密加工装置はレーザーを中心として好調な販売を維持すると予想し、精密加工ツールは対前年比約10%増を見込んでいます。なお、為替レートは1ドル80円を前提としています。このような市場の状況を勘案した結果、次期(2012年3月期)の連結業績は111億円の当期純利益を見込んでいます。

2012年3月期

(金額の単位：百万円)

売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
103,700	17,200	17,300	11,100	329.54円

地震に強い生産拠点

安心して取引できる会社を目指し、
地震の脅威に備えた体制づくりを進めています。



本社・R&Dセンター



呉工場



桑畑工場

積層ゴムによるダンパー効果は、
震動を低減する免震設備

ディスコは供給責任を果たし続けます

ディスコの製品は、世界中で使われている半導体の製造工程に欠かせないものとなっていますが、本社・R&Dセンターや工場などの主要機能は地震が起こる日本にあります。このためディスコは、より「安心して取引できる会社」「安心して働ける会社」になることを目指し、2003年からBCM^{*}体制の構築・維持に取り組んでいます。これから紹介する数々の地震対策を通じて、ディスコは安定した製品供給や高度なソリューションの提供を継続していきます。

※BCMとは？

Business Continuity Management 事業継続管理のこと。潜在的なリスクや顕在化したリスクが企業に及ぼす事業運営上の影響を特定し、確固とした方針を持って、災害時初期活動計画や災害時事業継続計画を管理、運用していきます。

■免震構造をもつ建屋の広がり

精密加工ツールを製造している呉工場B棟(2007年11月竣工)をはじめ、本社R&DセンターB棟(2008年11月竣工)、精密加工装置を製造する桑畑工場A棟(2010年1月竣工)、製品の主要部品や周辺機器などを生産している茅野工場A棟(2010年6月竣工)などでは、いずれも免震構造を採用しています。また、2011年11月には呉工場に免震構造を有する新棟を増設する予定です。免震構造は建物にある全ての柱と地面の間に配備され、地震の揺れを吸収し軽減します。これにより、万が一被災した場合にも、建屋内部にある製造設備は致命的な損傷を負うことなく早急な復旧を可能にします。

■原材料の確保

災害時の製品原材料調達を目的として、複数の調達ルートを確認しています。また特定の重要原材料については、免震構造棟内にある倉庫に6ヶ月～12ヶ月分の必要量を備蓄しています。

調達リスク対策

調達先の複数化	代替可能なものから順次複数社購買を実施
調達リードタイムが長期間、代替評価に時間がかかる生産部材	通常生産量の6ヶ月分を備蓄
ダイヤモンド砥粒	通常生産量の12ヶ月分を備蓄

■精密加工ツールの供給体制

日常的に消費される精密加工ツールは、その供給が滞ると半導体製品の生産体制に多大な影響を及ぼすことが考えられます。そこでディスコは2008年12月に事業継続マネジメントシステム規格「BS25999-2:2007」の認証を取得し、2011年1月にはその認証範囲を精密加工ツールにまで拡大しました。また、従来広島島の呉工場のみで行っていた精密加工ツールの製造ですが、主要品種については約10キロ離れた桑畑工場でも実施できる環境を

整えています。さらに、地理的に大きく離れた長野県の茅野工場においても、代替生産ができる体制の構築を検討しています。

■情報システム対策

製品供給に欠くことのできない各種電子情報は、東京と広島との2カ所に設置した電算システムへ、それぞれ二重に保管しています。通常時は免震構造棟がある本社(東京)のシステムにより管理されていますが、その運用が困難な状況になった場合には、ただちに広島事業所のシステムへ切り替えられる体制を整えています。これらのコンピュータシステムは定期的に切り替えテストを行っており、その安全性をより確実にしています。

■地震に強い体質づくり

地震による災害を最小限に留めるためには、建物などのハード面の対策に加え、従業員の安全意識向上などのソフト面の対策も重要です。「理想的な避難方法」「避難時の姿勢」「地震に耐える体勢」などを独自に研究し、全社を挙げて定期的に訓練や演習を行っています。また、災害時の緊急対策本部の設立補佐やケガ人の応急処置などを正式な業務として遂行する「災害対策要員」を本社R&Dセンターにて任命しています。



東日本大震災直後の社内。安全な場所で揺れに耐える従業員

※BS25999-2:2007とは？

事業継続管理(BCM)のための規格(英国規格協会)。企業の事業継続に対する潜在的脅威が現実となった際、早期復旧を実現するためにどのような対策を講じたらよいかを、予め明確化したものです。

